

58471

제품 정보



30µm 검은색 반응성 HAF 마운팅 테이프

제품 설명

tesa[®] HAF 58471은 페놀 수지와 니트릴 고무로 된 반응성 열활성 필름입니다. 기재가 없는 검은색 양면 테이프입니다. 강력 종이 라이너로 보호되어 있습니다.

tesa® HAF 58471은 할로겐 미함유 제품으로 현 RoHS(EU 제정) 기준에 부합합니다.

tesa® HAF 58471은 상온에서는 점착력이 없습니다. 조립 프로세스에서 열과 압력을 가하면 활성화됩니다.

특성:

- 오랜 기간 유지되는 안정적인 점착력
- 점착부위가 좁거나 설계 공차가 작은 경우에도 뛰어난 성능을 보임
- 매우 낮은 Oozing
- 강한 부하에 노출되는 장기 부착시 적합
- 탄성력있는 결합이 지속됨

특성

- · Extremely high performance, even on small bonding areas and thin design gaps
- · Reliable and ageing-resistant bonds
- · Very low oozing ratio
- · Suitable for long-term applications that are exposed to heavy stress
- · Free of halogen and compliant with current ROHS standards

Applications

 $tesa^{8}$ HAF 58471은 금속 부품을 각종 플라스틱 또는 금속 표면에 부착(SUS 또는 AL을 PMMA, PC 또는 ABS에 부착)하는 용도로 특히 적합한 제품입니다.

- 전자 기기 내부의 구조적 결합
- 버튼 고정
- 카메라 렌즈 및 베젤 마운팅
- 장식용 금속 부품 부착

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.



58471

제품 정보

제품 구조

 • 기재 소재
 없음
 • 총두께
 30 μm

 • 점착제 종류
 니트릴고무 /
 • 컬러
 검정

페놀수지 • 이형지 종류 글라신지

속성 / 성능 값

• 점착력 7 N/mm²

추가정보

Technical recommendations:

tesa HAF® is not self adhesive. It is activated by heat and pressure over a certain interval. The following values are recommendations for bond line parameters to start with.

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the first substrate. This step does not affect the shelf life time of the adhesive tape. Pre-laminated components can be stored over the same period of time as the adhesive tape.

setting:

- Temperature¹ 95-120 °C
- Pressure² 2-6 bar
- Time 3-10 s

2. Bonding:

Remove the liner from tape after pre-lamination step. Place the pre-laminated part onto the second substrate. Apply sufficient temperature while applying pressure for the bonding time to reach sufficient bonding strength.

setting:

- Temperature¹ 120-250 °C
- Pressure² 5-30 bar
- Time 5-180 s

Temperature, pressure and time will depend upon the type and thickness of the substrates. Generally, thicker substrates or lower bonding temperatures will require longer bonding times. To achieve optimum performance a cooling step (while applying pressure) directly after the bonding step is recommended.

¹ 'Pre-lamination' and 'Bonding' temperature refer to the data that is measured in the bond line.

² 'Pre-lamination' and 'Bonding' pressure refer to the force that is transformed from jig surface directly to the bonding area.



58471

제품 정보

추가정보

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. (Material: etched aluminum test specimen / bonding conditions: temperature = 180 °C; pressure = 10 bar; time = 7 sec).

To reach maximum bonding strength surfaces should be clean and dry. Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.

공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고

있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성

또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다

